

KOMBI RAPID

Klej do płyt styropianowych



GŁÓWNE ZALETY

- Wysoka izolacyjność termiczna (wsp. $\lambda = 0,0348 \text{ W/m}^2\text{K}$), bez ryzyka mostków termicznych
- Niski przyrost objętości i wysoka stabilność wymiarowa
- Wysoka przyczepność i odporność mechaniczna
- Szybki czas wiązania
- Łatwa aplikacja i dobre właściwości robocze

DANE TECHNICZNE

Czas otwarty: do 10 minut*

Czas korekty położenia przyklejonej płyty styropianowej: do 10 minut

Czas utwardzenia kleju (przy wilgotności wzgl. powietrza 50% i temp. 23°C): 2 godziny**

Odporność termiczna po utwardzeniu: od +40°C do +90°C

Wydajność: do 8m²* (ocieplanie ścian) oraz do 12m²* (fundamenty, piwnice, przyziemie)Przyczepność do betonu: $\geq 0,3 \text{ MPa}$ Przyczepność do styropianu: $\geq 0,1 \text{ MPa}$ (zerwanie w masie)

Temperatura otoczenia i podłoża oraz utwardzania kleju: od +1°C do +30°C (zalecana od +10°C do +25°C)

Temperatura puszk: od +5°C do +25°C (optymalnie +20°C)

Warunki aplikacji na zewnątrz budynku: pogoda bezdeszczowa, unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze

Wielkość opakowania: puszka metalowa zawierająca 750 ml kleju

Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji podanej na denku puszk.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C.

ZASTOSOWANIE

Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą bezspoinową (ETICS) oraz klejenie płyt ze styropianu ekspandowanego (EPS) lub styropianu ekstrudowanego (XPS) do podłoży mineralnych (jak np. beton, ceramika) w systemach, w których płyty izolacji ciepłej są jednocześnie mocowane mechanicznie do podłoża (wg projektu technicznego). Termoizolacja fundamentów, ścian i piwnic (mocowanie płyt styropianowych EPS, EPS do podłoży mineralnych i bitumicznych). Wypełnianie szczelin pomiędzy płytami styropianowymi, szczelin powstałych na skutek docinania płyt. Dylatacje pionowe w murach. Uszczelnianie złączy, np. przy parapetach, płytkach parapetowych, płytach balkonowych, oknach piwnicznych czy oknach w przyziemiu.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), czyste, odtłuszczone, odpylone i wyrównane. Dopuszczalne odchylenie powierzchni ściany nie może przekroczyć -4 mm i +2 mm (pomiar dokonany łatą o dł. 2 m z dokładnością do 1 mm). W przypadku większych nierówności wykonać warstwę wyrównawczą. Fundamenty i ściany oczyścić mechanicznie z zabrudzeń oraz porostu glonów i grzybów, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Podłoże musi być zabezpieczone przed podciąganiem kapilarną wilgoci i przed przeciekaniem wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę by na klejonych powierzchniach nie było szronu. Płyty izolacyjne (inaczej niż cięte) mogą zawierać środki antyadhezyjne. Przeprowadzić test przyczepności. W razie potrzeby powierzchnię tynłą płyt przeszlifować. Dla zwiększenia przyczepności, przyspieszenia utwardzania i poprawy struktury, podłoże należy wstępnie zwilżyć wodą za pomocą rozpylacza.

Przygotowanie kleju: Bezpośrednio przed użyciem puszkę z klejem bardzo dobrze wymieszać. Nakręcić na pistolet. Początkową partię kleju (ok. 30 cm), aż do wyrównania się ciśnienia w pistolecie skierować na bok nie (do użycia). Przyklejanie płyt zaczynać zawsze od dołu, opierając dolny rząd na listwie startowej lub na stopie fundamentowej. Ewentualne zabrudzenia usuwać przy pomocy specjalnych ściereczek czyszczących lub za pomocą czyścika do piany poliuretanowej. **Uwaga:** Czyścik może wejść w reakcję z płytą styropianową i doprowadzić do jej uszkodzenia. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie. Miejsca w których klej jest wyeksponowany na działanie promieniowania UV należy zabezpieczyć w ciągu 10 dni od nałożenia kleju. Do ochrony przed promieniowaniem UV stosować zaprawy, silikon lub akryl.

Klejenie płyt przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków: Klej nakładać na płyty po obwodzie z zachowaniem dystansu 2 cm od krawędzi płyty oraz pasmem w kształcie litery „M” lub „W”. W ciągu maksymalnie 10 minut od nałożenia kleju płyty należy przyłożyć do podłoża i docisnąć, używając łaty. Korektę równości ułożenia płyt można przeprowadzić maksymalnie do 10 minut od ich przyklejenia. Kółkowanie można rozpocząć po upływie 3 godzin od przyklejenia. Spoina klejowa uzyskuje pełną wytrzymałość mechaniczną po 24 godzinach od przyklejenia płyt. Uwaga: Czas wiązania może ulec wydłużeniu w przypadku występowania niskiej temperatury i niskiej wilgotności powietrza.

Klejenie płyt przy termoizolacji fundamentów, ścian piwnic i tym podobnych podziemnych części budynków: Klej nakładać jednostronnie na podłoże pionowymi paskami z zachowaniem odstępów 20÷30 cm. W przypadku płyt o szer. 150÷160 cm, należy nałożyć przynajmniej 5 pasmów. Płyty przyłożyć do podłoża po ok. 10 minutach od nałożeniu kleju, a następnie docisnąć. Pozostałe szczeliny i złącza między płytami podobnie wypełnić klejem.

Wskazówki wykonawcze: Przy termoizolacji podziemnych części budynków klej można stosować wyłącznie w systemach hydroizolacji lekkiej przeciwwilgociowej – przeprowadzić test przyczepności. Nie stosować w przypadku ciągłej ekspozycji na działanie wody np. zanurzenie spowodowane wysokim poziomem zwierciadła wód gruntowych – hydroizolacja ciężka lub przeciwwodna. Nie stosować do klejenia PE, PP, teflonu, powierzchni silikonowych, pokrytych środkami poślizgowymi, nawilżającymi (membrany z filmem PE). Nie stosować do podłoży hydroizolowanych za pomocą bitumicznych wyrobów rozpuszczalnikowych – ryzyko uszkodzenia płyt (zapoznać się dokładnie z instrukcją wyrobu i sprawdzić czy producent przewiduje możliwość klejenia płyt styropianowych). Płyty można kleić po całkowitym wyschnięciu powłok hydroizolacyjnych – zapoznać się z instrukcją wyrobu. Nie stosować podczas opadów atmosferycznych, silnego wiatru czy przy silnym nasłonecznieniu.

* czas otwarty oraz wydajność zależą w dużym stopniu od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz podłoża, temperatury puszk, sposobu zastosowania, przekroju nałożonej warstwy, zwilżenia podłoża itp.

** czas utwardzania jest uzależniony od warunków atmosferycznych.